

联络函

尊敬的客户：

首先，感谢您一直以来对我司的支持！

为了进一步提升品牌形象，优化产品识别度，我司决定对产品的型号及刻字进行统一变更。

由于目前我司出华强市场的晶导产品均为中性印字，我司计划于2025年1月开始出货全部统一为晶导标准刻字，同时规范标签型号。但是由于在途订单及备货库存较多，预计会有半年到一年的过渡时间。在此期间，会有新旧两种刻字的产品并存，还望理解。

具体刻字变更前后图示请参考附件。

因刻字统一给您带来的不便我们深表歉意，希望得到您一如既往的支持！

山东晶导微电子股份有限公司
2024年12月27日





晶导微电子

Jingdao Microelectronics

(封装外观图片、字符数均为示意图，以实际为准)

封装		统一前 Before Change	统一后 After Change
SOD-123W			
SOT-23	型号代码 字数 ≤ 3		
	型号代码 字数 > 3		
SOT-26		-	
SOD-123HE、SMA-W			
MBF-T、MBF-W			
SOD-523、SOD-323FLW SOD-323W、SOD-323HE			
SOP-B			
LB1			

(封装外观图片、字符数均为示意图, 以实际为准)

封装	统一前 Before Change		统一后 After Change	
	单向	双向	单向	双向
SOD323、SOD323FL				
SOD-123				
SOD-123FL、SMA、SMAF、SMB、SMBF、SMC				
3225、SMD-3225				
4032				
ABF、ABS、MBF、MBS、UMB				
UMSB、ULBF				
KBP				
GBU				
GBJ				